EFC 易發精機
EASY FIELD CORPORATION

COG BONDING M/C

技術規格

1	CHIP tray盤供料(自動翻轉IC)
2	壓合精度 X,Y ± 3μm
3	溫度設定RC~399°C
4	壓合壓力2~30kg/cm

設備特性與優點

將CHIP透過自動傳送及對位精準壓合在玻璃上。